

技術詞彙表

本技術詞彙表包含本文件所用的若干技術詞彙的解釋。因此，該等詞彙及其涵義未必與業內的標準涵義或用法一致。

「ADB」	指	自適應遠光燈，一種根據路況調整車前大燈的燈光方向和強度，以擴大駕駛員的視野及盡量減少對其他駕駛員的眩光影響的技術
「汽車主機廠」	指	於新車製造過程中組裝及安裝汽車零部件的製造商
「AI」	指	人工智能
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「CASN」	指	一種具有與CaAlSiN ₃ 相同晶體結構的物質，以及一種其主要成分為CaAl _{1-x} Si _{1-x} N _{3-x} O _x 晶體的物質，其中每種Ca、Al及Si的一部分可被二價金屬元素(II金屬元素值)、三價金屬元素(III金屬元素值)或四價金屬元素(IV金屬元素值)取代
「CNAS」	指	中國合格評定國家認可委員會
「COB」	指	板上芯片，一種將多顆LED芯片集成至一塊电路板的封裝工藝
「顯色指數」	指	顯色指數，為衡量光源忠實還原在自然光或基準光源下的各種物體顏色的能力的定量指標
「直下式」	指	一種用於液晶顯示屏的照明方法，其將LED面板直接置於顯示堆棧後面，以在屏幕上產生視覺效果

技術詞彙表

「DLP」	指	數字光處理，一套基於光學微機電技術並採用數字微鏡器件的芯片組。DLP技術用於各種顯示應用，從傳統的靜態顯示到互動顯示，以及非傳統的嵌入式應用，包括醫療，安保和工業用途
「DOB」	指	含驅動的燈板，一種用於LED照明系統的技術，其將驅動器直接集成於LED電路板上
「拔模角度」	指	在模具的垂直表面上略微傾斜，以利於取出成品
「側入式」	指	一種用於液晶顯示屏的照明方法，其將LED沿屏幕邊緣放置，以在屏幕上產生視覺效果
「EMC」	指	環氧樹脂模塑料，一種用於通過注塑機及注塑工藝利用LED器件高運用功率生產體積小、耐高溫支架的環氧材料
「倒裝LED」	指	一種LED結構，與正裝LED相比，其電氣面朝下，並無金屬線進行電連接
「建築面積」	指	建築面積
「HCM」	指	前大燈控制模組，一種提供最佳照明效果的先進車輛前照明控制系統
「HD」	指	高清
「HUD」	指	抬頭顯示，一種無需駕駛員將視線從其慣常視角移開即可將重要信息投影至風擋玻璃上的顯示

技術詞彙表

「IATF16949」	指	由國際汽車工作組(IATF)和ISO編製的國際汽車工業質量管理體系技術規範
「集成電路」	指	集成電路，由單個不可分割的結構(如芯片)組成的小型單元或封裝結構，其電氣性能等同於由許多獨立元件組成的傳統電路
「知識產權」	指	知識產權
「紅外」	指	紅外，一種波長大於可見紅光但小於微波的電磁波輻射
「ISO」	指	國際標準化組織，一個由各國標準化團體組成的世界性聯合會
「ISO14001」	指	ISO發佈的環境管理體系
「ISO45001」	指	ISO發佈的職業健康安全管理體系
「ISO9001」	指	ISO發佈的國際質量管理體系
「ISD」	指	交互信號顯示
「信息技術」	指	信息技術
「正裝LED」	指	需要使用金屬線進行電連接且P及N金屬電極位於發光部位同側的LED結構。其結構組成從上到下包括P-GaN、發光層、N-GaN和基板
「「LED+」技術」	指	將LED技術與集成電路(IC)、電子控制、軟件、傳感器及光學等相結合的技術，這些技術正在迅速改變高端LED智能視覺行業格局

技術詞彙表

「液晶」	指	液晶顯示器，一種平板顯示器或其他電子調製光學器件，其利用了液晶與偏振器結合的光調製特性
「支架」	指	LED或集成電路器件中固定LED或集成電路芯片、提供機械支撐、電連接及熱傳導的封裝載體。其通常包括金屬片、塑料材料等
「LED」	指	發光二極管，一種在電流通過時發光的半導體二極管
「LED器件」	指	通過LED封裝工藝製造的發光半導體器件
「LED模組」	指	由單顆或多顆LED器件、驅動電路、控制電路等組裝而成的整體單元
「lm/W」	指	流明／瓦
「局部調光」	指	一種LED屏幕中用於改善畫質的LED背光技術。其工作原理是將屏幕上需要變暗的背光區域調暗，同時保持屏幕明亮背光部分的亮度，從而提高對比度，提供更好的畫面效果
「Micro LED」	指	芯片尺寸小於100微米的發光二極管
「Mini LED」	指	芯片尺寸介於100微米至300微米之間的發光二極管
「製造商建議零售價」	指	製造商建議零售價
「新能源車」	指	新能源車
「N-GaN」	指	N型氮化鎵，一種含有特定雜質的半導體材料，可產生大量自由電子，從而有效攜帶負電荷
「整體設備效率」	指	整體設備效率，為衡量製造設備生產率的標準

技術詞彙表

「OHSAS18001」	指	職業健康安全管理體系要求，用於管理與企業相關的健康和安全風險
「OTA」	指	空中下載，一種通過網絡對汽車軟件和固件進行遠程更新的技術
「PAR」	指	光合有效輻射，植物進行光合作用需要的光波長(介於400nm至700nm之間)
「PCB」	指	印刷電路板
「PCBA」	指	印製電路板組裝，在PCB上安裝或放置電子部件以實現其功能的過程
「光電轉換效率」	指	光電轉換效率，即照明產品將電能轉換為可見光的比例，為衡量照明產品性能及能效的重要指標
「PPE」	指	光合光子效率，一項測量照明系統每電功率每秒產生的PAR總量的指標
「PPF」	指	光合光子通量，一項測量照明系統每秒產生的PAR總量的指標。在植物應用中，PPF對了解照明系統對植物生長的有效性至關重要
「P-GaN」	指	P型氮化鎵，一種摻入特定雜質的半導體材料，可產生大量並無電子的空穴，從而有效攜帶正電荷
「研發」	指	研發
「SMD」	指	表面貼裝器件，一種能夠通過SMT工藝安裝至PCB在封裝基板上帶有正負電極的LED封裝器件

技術詞彙表

「SMT」	指	表面貼裝技術，一種用於組裝PCB的方法，其將元件直接貼裝在電路板表面的指定位置
「平方米」	指	平方米
「基板」	指	用於製造半導體元件和PCB的基礎材料
「一級供應商」	指	直接向汽車主機廠供應零部件或系統的公司。汽車行業其他類型的供應商包括二級供應商和三級供應商。二級供應商向一級供應商供貨。三級供應商向二級供應商供貨
「紫外」	指	紫外，一種波長小於可見光但大於X射線的電磁波輻射
「UVC」	指	波長介於200nm至280nm之間的紫外線
「瓦」	指	瓦